



PROCESOS DE INSPECCIÓN VISUAL de la PCB

OBJETIVOS

El programa de formación se centra en todo aquello que los trabajadores de la línea de producción, los operarios, los inspectores, los ingenieros y los compradores necesitan saber para realizar inspecciones o tomar decisiones sobre aceptación o disconformidad de las placas de circuito impreso (PCB). Así mismo, se alcanza una visión global de los estándares IPC, preparando al alumno para una futura obtención de la certificación CIS en el estándar IPC 610

CONTENIDOS TEÓRICOS

- Criterios de soldadura, incluyendo las conexiones sin plomo.
- Requisitos de soldadura de conexiones a terminales.
- Requisitos de soldadura de conexiones para las placas con orificios con soporte.
- Criterios de montaje superficial para los componentes chip, encapsulados chip con y sin patillas.
- Requisitos de los disipadores térmicos de los montajes mecánicos y de los componentes.
- Criterios de montaje de componentes DIP, pernos y conectores de borde de tarjeta.
- Requisitos de montaje de los cables puente.
- Criterios de dimensiones del filete de soldadura para los principales grupos de componentes SMD.
- Defectos de la soldadura, como el efecto lápida, el desmojado, formación de cavidades y otros.
- Criterios en cuanto al deterioro de componentes, condiciones del laminado, limpieza y barnizado.

CONTENIDOS PRÁCTICOS

- Identificación práctica de violación de criterios y requisitos
- Identificación recubrimiento conformal

- Duración: 30horas.
- Horario: De tarde. Indicada en web

Curso subvencionado al 100% Lanbide Ocupados



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: SALESIANOS DEUSTO
Avda. Lehendakari Aguirre, 75 48014 - Bilbao Tfno.: 944 472 650
www.salesianosdeusto.com informacion@salesianosdeusto.com